

北京第三代半导体产业技术创新战略联盟标准化委员会（CASAS）

团体标准公告

根据北京第三代半导体产业技术创新战略联盟标准化委员会管理和标准制修订细则的有关规定，由广州南砂晶圆半导体技术有限公司组织制定的《碳化硅晶片位错密度检测方法 KOH 腐蚀结合图像识别法》（T/CASA 013—2021）、《碳化硅衬底基平面弯曲的测定 高分辨 X 射线衍射法》（T/CASA 014—2021）等 2 项团体标准。已按规定程序审查、审批通过，现予以发布。

标准编号及名称如下：

T/CASA 013—2021 《碳化硅晶片位错密度检测方法 KOH 腐蚀结合图像识别法》

T/CASA 014—2021 《化硅衬底基平面弯曲的测定 高分辨 X 射线衍射法》

北京第三代半导体产业技术创新战略联盟

2021 年 11 月 1 日

